

# AI化、IoT化に向けた半導体パッケージ技術の進化と要素技術 ～DIP から FOWLP・CoWoS まで～

## 講師：磯部 晶 氏

### (株式会社 ISTL 代表取締役社長)

Appleが採用したFOWLP技術が話題になりましたが、今後のIoT、AI化の進展に伴い、半導体パッケージ技術は大きく変化しつつあります。半導体パッケージはDIPを原点とし、様々な形態に進化してきましたが、それは「高性能化」、「多機能化」、「小型化」の3つのキーワードに従ったものです。本セミナーではパッケージ技術の進化と要素技術を、最新の方式であるFOWLPやCoWoSに至るまでわかりやすく解説します。

#### 【講師経歴】

1984年 日本電気(株)入社、半導体プロセス技術 多層配線技術、CMP等  
2002年 (株)東京精密 執行役員CMPグループリーダー  
2006年 ニッタハース(株)入社 テクニカルサポートセンター長等  
2013年 (株)ディスコ入社  
2015年 (株)ISTL設立

#### 【活動】

博士(工学)、プラナリゼーション研究会幹事、所属学会：精密工学会、応用物理学会、Electro Chemical Society

開催日時	2018年3月19日(月) 13:30～16:30	【会場】
受講料	49,000円(税込) ※資料代含 *メルマガ登録者 44,000円(税込) *アカデミック価格 15,000円(税込)	ちよだプラットフォームスクウェア B1Fミーティングルーム005 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-21

\*アカデミック価格:学校教育法にて規定された国、地方公共団体、および学校法人格を有する大学、大学院の教員、学生に限ります。  
★【メルマガ会員特典】2名以上同時申込で申込者全員メルマガ会員登録をしていただいた場合2人目以降はメルマガ価格の半額です。  
★【セミナー対象者】半導体のパッケージ技術を基礎から学びたいという技術者、営業、マーケティング担当者等  
★【セミナーで得られる知識】①半導体パッケージ技術の変遷とその背景、②半導体パッケージ製造工程と材料、装置、③最先端パッケージ技術と今後の方向性

#### 【本セミナーのプログラム】

※適宜休憩が入ります。

- 近年のデバイストrend  
IoT、AIで求められるものは？
- 半導体パッケージの役割  
2.1 前工程と後工程  
2.2 基板実装方法の変遷  
2.3 半導体パッケージの要求事項
- 半導体パッケージの変遷  
3.1 PC、携帯電話の進化とパッケージ形態の変化  
3.2 STRJパッケージロードマップ  
3.3 各方式の説明～DIP、QFP、TCP、BGA、QFP、WLCSP等
- 電子部品のパッケージ  
4.1 半導体以外の電子部品  
4.2 電子部品のパッケージ～MEMS、SAWデバイス、LED、IS
- 最新のパッケージ技術と今後の方向性  
5.1 様々なSiP  
5.2 FOWLPとは？  
5.3 CoWoSとは？  
5.4 パッケージ技術の今後の方向性

弊社記入欄		セミナー申込書			
セミナー名		AI化、IoT化に向けた半導体パッケージ技術の進化と要素技術			
所定の事項にご記入下さい メルマガ会員、登録希望の場合は○		会社名(団体名)	TEL:		
↓		住所	FAX:		
↓			E-mail:		
会員登録済み	新規登録希望	部署	役職	氏名	
お支払方法		銀行振込・その他		お支払予定	2018年 月 日頃

■申込方法：セミナー申込書にご記入の上FAXまたはE-mail(re@cmcre.com)でお申し込みください。  
■セミナーお申込み後のキャンセルは基本的にお受けしておりません。ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。  
■申込先：(株)シーエムシー・リサーチ 東京都千代田区神田錦町2-7 TEL03-3293-7053  
■本セミナーの関連情報は、弊社HPでもご覧いただけます。⇒ <http://www.cmcre.com>

参加申込 FAX 番号  
**03-3291-5789**